

Orbotech Diamond™ GWXL

應用於玻璃基板的白色防焊直接成像



Orbotech Diamond GWXL

Orbotech Diamond GWXL 是高產能高階的防焊直接成像 (DI) 解決方案，專為應對玻璃基板上白色防焊應用的獨特挑戰而設計 (例如 miniLED)。

Orbotech Diamond GWXL 是基於經業界驗證的 Orbotech Diamond 10W 解決方案而設計的新一代產品。是用於白色防焊系統的專用機型，能夠實現高品質成像及高產能。

採用 KLA 專利的 SolderFast™ 技術，Orbotech Diamond GWXL 提升了白色防焊直接成像的標準，在加強了成像精度及品質的同時減少了整體擁有成本 (TCO)。



優勢

高品質成像

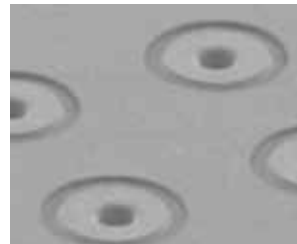
- 白色防焊在玻璃基板上的高品質成像
- 多波長可實現高品質側壁及優異的表面品質
- 顯著減少白色防焊的底切
- 高景深 (DOF) 適用於高低差大的表面

高產能，快速產出

- 專利高能量照明光源
- 一次曝光成像，單次曝光即可完成全板均勻成像
- 雙檯面傳輸機制優化成像時間
- 即時靶點識別及捕捉功能
- 自動化就緒以用於玻璃處理

卓越的成像精度

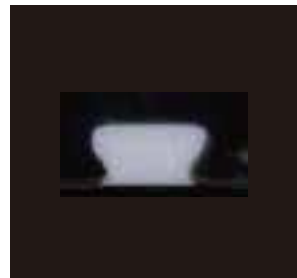
- 對位精度高達 $\pm 10\mu\text{m}$
- 獨特的對位方法用於被白色防焊遮蓋住的靶點
- 高階漲縮模式和演算法，克服板材變異



高品質防焊成像



高對位精度

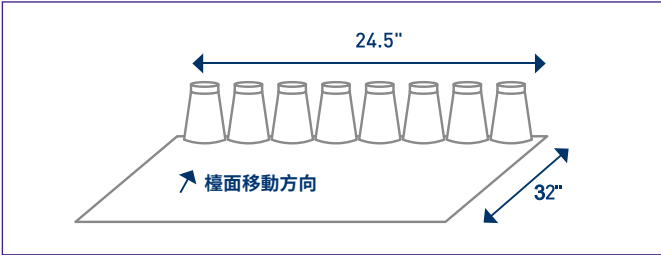


Orbotech Diamond GWXL
白色防焊橋，最小底切

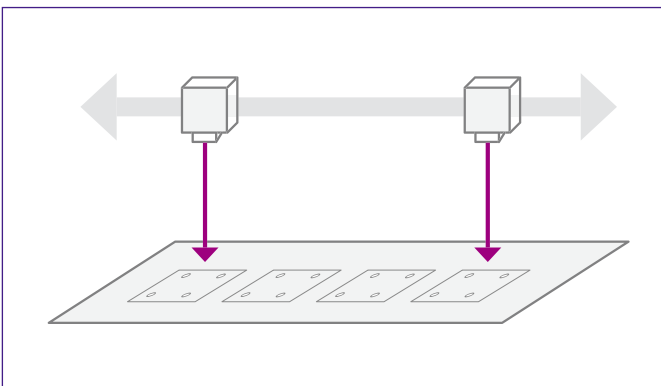


其他防焊直接成像方案
白色防焊橋，明顯的底切

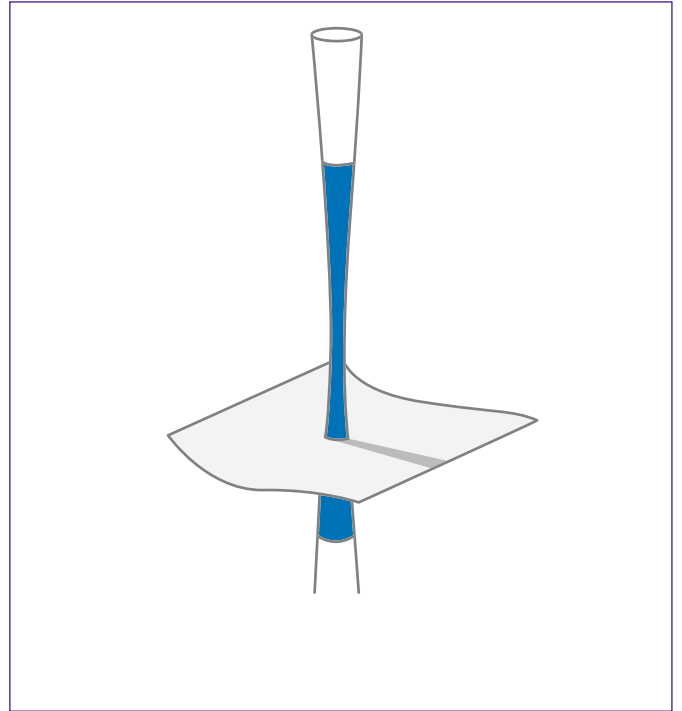




一次成像實現快速產出，成像均勻且沒有拼接問題



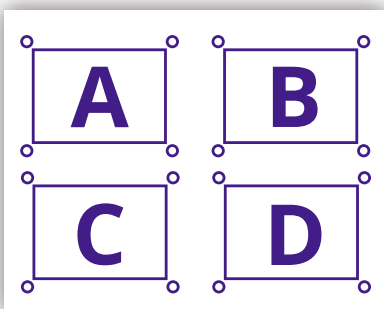
即時靶點識別及捕捉



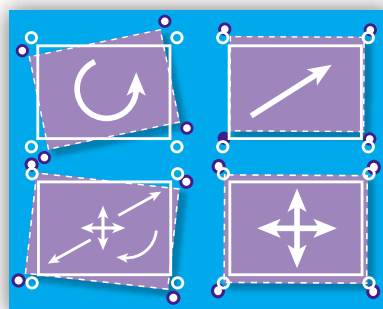
高景深 (DOF) 適用於高低差大的表面

卓越的成像精度

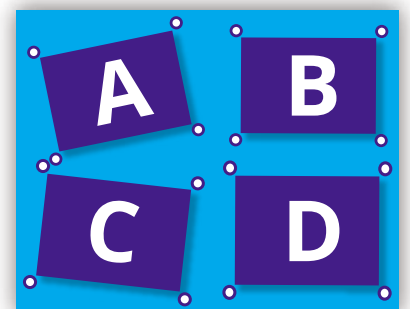
高階漲縮模式和演算法可以克服具有挑戰性的板子變形，包括自動漲縮，局部漲縮及非線性漲縮



數據



板子



圖像

规格

最小開窗*	100µm
最小防焊橋*	75µm
對位精度**	±10µm
最大板子尺寸 (X/Y)	25" x 32" (635mm x 812mm)
最大曝光尺寸 (X/Y)	24.5" x 32" (622mm x 812mm)
曝光能量範圍	50-2,200 mJ/cm ²
尺寸	高: 1,960mm 深: 3,315mm 寬: 1,900mm
重量	5,000Kg
應用	應用於玻璃基板的白色防焊曝光

*取決於防焊油墨類型及制程

**所有值均為 3σ

上述規格如有變更，恕不另行通知

KLA 支持

保持系統生產力是 KLA 良率優化解決方案不可或缺的一部分。包括系統維護、全球供應鏈管理、降低成本和減少報廢、系統遷移、性能和生產率提升以及轉售認證設備。

KLA Corporation

www.orbotech.com/pcb | www.kla.com

Rev 1_3-10-2022

© 2022 KLA 公司。所有品牌或產品名稱可能為其各自公司的商標。KLA 保留在不另行通知的情況下更改硬體和/或軟體規格的權利。